

2023 年 6 月 13 日

トヨーケム株式会社

COMNEXT に次世代高速通信向けエレクトロニクス製品を出展

トヨーケム株式会社（代表取締役社長 町田 敏則、東京都中央区）は、2023 年 6 月 28 日（水）～30 日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「COMNEXT 第 1 回 [次世代] 通信技術&ソリューション展」に、高速通信に対応する各種エレクトロニクス製品を出展いたします。

「COMNEXT 第 1 回 [次世代] 通信技術&ソリューション展」は、5G/6G 通信技術・材料、通信ソリューション、光通信技術、映像伝送/8K 技術などの製品やソリューションが集結する国際商談展です。

今回トヨーケムは、6G を見据えた低誘電特性を備え持つポリマーや、封止基板のノイズ対策用シールドシートなどを出展します。当社独自の樹脂設計技術で開発したポリマー製品で、次世代高速通信の安定性に貢献します。

記

会期	2023 年 6 月 28 日（水）～30 日（金） 10:00～18:00（最終日は 17:00 終了）
会場	東京ビッグサイト（東京都江東区） 西展示場
ブース番号	5G・6G 材料エリア 8-7
主催	RX Japan 株式会社
出展製品	<ul style="list-style-type: none">● 低誘電ポリマー 5G/6G など高速通信時の誘電喪失を低減する高速通信向けポリマー● 3D 成型シールドシート LIOTELAN® 半導体パッケージや封止基板のノイズ対策用途で高段差や複雑な形状をシールドできるシート● 実装基板保護絶縁シート LIOTELAN® 実装部品基板上の任意のエリアを被覆する絶縁シート● 熱伝導シート LIOELM® FTS パワーデバイスモジュールや放熱基板の熱対策用で柔軟性に優れた熱伝導接着シート

- 「COMNEXT 第 1 回 [次世代] 通信技術&ソリューション展」 公式ウェブサイト
<https://www.cbw-expo.jp/ja-jp.html>

News Release

トヨーケム株式会社 〒104-8379 東京都中央区京橋 2 丁目 2-1 京橋エドグラン Tel: 03-3272-5743 Fax: 03-3272-7308
Toyochem Co., Ltd. Kyobashi EDOGRAND Bldg., 2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 JAPAN
Tel: +81-3-3272-5743 Fax: +81-3-3272-7308 URL: www.toyo-chem.com Mail: info@toyoinkgroup.com

※ TOYO CHEM、TOYO CHEM ロゴ、LIOTELAN および LIOELM は、東洋インキ SC ホールディングス株式会社の商標
もしくは登録商標です。

以上

<u>本件に関するお問い合わせ先</u>	<u>報道・出版関連、その他一般の方々</u>
トヨーケム株式会社 情報通信営業本部 TEL: 03-3272-0904	東洋インキ SC ホールディングス株式会社 グループ広報室 TEL: 03-3272-5720 MAIL: info@toyoinkgroup.com